

フレックスリジッド基板

Flex-Rigid Printed Circuit Board

特長 Features

- 選択的に折り曲げ可能な構造
Selectively bendable structure
- 接続コネクタレスによるコンパクト化と、組み立て工数を削減
Connectorless compact design, Moreover, the number of assembly man-hours is reduced.
- 試作～小ロット生産：本社工場およびベトナム工場
Sample-Small Volume Production: Headquarters Factory, Sample-Volume Production Vietnam Factory
- 貫通及びビルドアップ構造対応可能
Correspondence of PTH and Build-up Layer

用途 Application

カメラモジュール
Camera Module



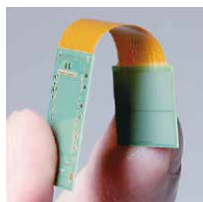
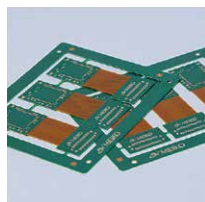
家庭用ゲーム機器
Home game equipment



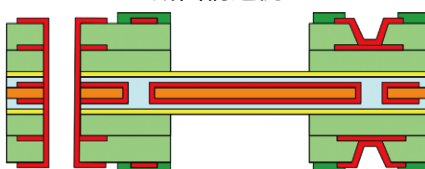
通信モジュール機器
Communication module equipment



構造例 Constructional Example



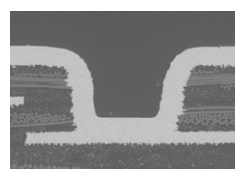
断面構造例



FPC部 IVH



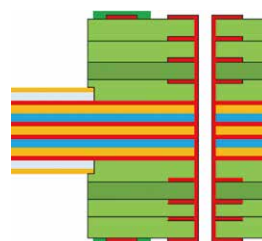
LVH



基板仕様 PWB Specification

項目		一般仕様		特殊仕様
パターン/スペース	ビルドアップ層	0.075mm/0.075mm		0.04mm/0.05mm
	フレキ層	0.075mm/0.075mm		0.04mm/0.05mm
貫通スルーホール	ドリル径	$\phi 0.25\text{mm}$		$\phi 0.12\text{mm}$
	ランド径	外層	$\phi 0.50\text{mm}$	$\phi 0.32\text{mm}$
IVH	ドリル径	$\phi 0.25\text{mm}$		$\phi 0.20\text{mm}$
	ランド径	外層	$\phi 0.50\text{mm}$	$\phi 0.40\text{mm}$
		内層	$\phi 0.55\text{mm}$	$\phi 0.40\text{mm}$
レーザービア	ビア径	$\phi 0.10\text{mm}$		$\phi 0.085\text{mm}$
	ビアランド径	$\phi 0.25\text{mm}$		$\phi 0.18\text{mm}$

FPC複層コア対応



ANY-LAYER対応

